

SEDEX 2017

The 19th Semiconductor Exhibition

Since 1999

제19회 반도체대전

2017.10.17(TUE)~10.19(THU)
coex Hall C(3F), SEOUL

반도체대전(SEDEX)은 한국전자전(KES), 한국디스플레이산업전(IMID)과 동시개최 됩니다.
한국전자산업대전 (Korea Electronics Grand Fair)

주최 산업통상자원부 주관 KSIA 한국반도체산업협회 KEA 한국전자정보통신산업진흥회 KDA 한국디스플레이산업협회

SEDEX Overview

행사 개요

- 명 칭 제19회 반도체대전
- 기 간 2017. 10. 17(화)~19(목), 10:00~17:00
- 규 모 183개사 517개 부스
- 참여국 Korea, China, Japan, Taiwan, USA, Germany, India, Czech
- 주 최 산업통상자원부
- 주 관 KSIA 한국반도체산업협회
- 후 원 SK 이머니스 삼성전자 MOTION CONTROL ETRI 한국전자통신연구원 KDA

OVERVIEW

- Title The 19th Semiconductor Exhibition (SEDEX 2017)
- Period 2017. 10. 17(Tue)~19(Thu), 10:00~17:00
- Size 183 exhibitors 517 booths
- Participating Countries Korea, China, Japan, Taiwan, USA, Germany, India, Czech
- Host KSIA KOREA SEMICONDUCTOR INDUSTRY ASSOCIATION
- Organizer KSIA KOREA SEMICONDUCTOR INDUSTRY ASSOCIATION
- Partners SK hynix SAMSUNG ELECTRONICS MOTION CONTROL ETRI KDA

한국전자산업대전 개요

- 명 칭 : 한국전자산업대전(KEGF, Korea Electronics Grand Fair)
- 기 간 : 2017. 10. 17(화)~10. 19(목), 3일간 ※ 한국전자전(10. 17(화)~20(금), 4일간)
- 장 소 : 서울 삼성동 Coex Hall A~B(1층), C~D(3층)
※ 한국전자전 KES(Hall A~B), 반도체대전 SEDEX(Hall C), 디스플레이산업전 iMID(Hall D)
- 행사기관
 - 주최 : 산업통상자원부
 - 주관 : 한국반도체산업협회(KSIA), 한국디스플레이산업협회(KDIA), 한국전자정보통신산업진흥회(KEA)

규모

- 참가기업 : 20개국 800여개사 1,900부스
- 참 관 객 : 60,000여명 (해외바이어 3,000여명)

주요내용

- 전 시 회 : 반도체, 디스플레이, 대중소기업 상생협력, 4차 산업혁명 전략산업, 스마트가전, 전자부품&시스템, SW 등
- 컨퍼런스 : 개막 기조연설, IoT생태계혁신 등 기술세미나, 국제학술대회, 제품개발 전략발표회, 반도체 디스플레이 시장동향 세미나 등
- Biz 상담회 : 미국, 유럽, 중국, 중동 등 20여개국 초청바이어 수출상담회, VC 투자유치 상담회 등

SEDEX Opening Keynote

2017 반도체대전 Opening Keynote

- 일 시 2017년 10월 17일(화) 10:00~12:00
- 장 소 COEX Hall E
- 주 최 한국반도체산업협회
- 문 의 SEDEX 전시사무국 (Tel : 02-570-5229)

시간	내 용	연 사
10:00~10:40	SK Telecom moving towards 5G	SK텔레콤 Network 기술원장 박진효
10:40~11:20	Connected Car & Semiconductor	BMW Korea R&D 연구소장 마틴 빌레
11:20~12:00	세계반도체시장동향 분석 및 전망	IHS Markit 반도체산업 부사장 랜 젤라넥

* 본 행사는韓·英·美 동시통역 서비스가 제공됩니다.

* 현장 선착순으로 자리가 한정되며, 행사장 만석 시 출입이 불가할 수도 있습니다(10.17(화) 09:30부터 입장 가능).

	Jin Hyo Park 박진효 SK 텔레콤 Network 기술원장		Martin Weohrlé 마틴 빌레 BMW Korea R&D 연구소장		Len Jelinek 랜 젤라넥 IHS Markit 반도체산업 부사장
---	---	---	--	---	---

2017 한국전자전 Opening Keynote

- 일 시 2017. 10. 17(화) 13:30~16:00
- 장 소 COEX 그랜드컨퍼런스룸 401호
- 주 최 한국전자정보통신산업진흥회(KEA)
- 문 의 한국전자전 사무국 이현우 과장 (Tel : 02-6388-6064)

시간	회 사	내 용	연 사
14:00~15:00	Mercedes-Benz	Digitalization and its effects on Procurement and Supplier Quality at Mercedes-Benz Cars. (디지털화가 메르세데스-벤츠 공급부문의 구매 및 공급 품질 관리에 미치는 영향)	독일 메르세데스-벤츠 본사 공급부문 구매 및 공급품질 커무니케이션 총괄 요헨 셰퍼스
15:00~16:00	Intel	The big picture of autonomous driving (자율주행 자동차가 가져올 거대한 미래와 인텔의 전략) Intel's End-to-End solutions for AD (인텔의 5G, 인공지능, 클라우드 기반의 자율주행 자동차 전략)	다임러 범용화면 자체 & 외장 구매 공급 및 원자회 담당 디렉터 마티아스 라이프 인텔코리아 대표 권명숙 인텔코리아 기술지원 총괄, 전무, PhD 김두수

* 현장 선착순으로 자리가 한정되며, 행사장 만석 시 출입이 불가할 수도 있습니다(10.17(화) 13:30부터 입장 가능).

	Mr. Jochen Schaefers 요헨 셰퍼스 독일 메르세데스-벤츠 본사 공급부문 구매 및 공급품질 커무니케이션 총괄		Ms. Myung-sook Kwon 권명숙 인텔코리아 대표 인텔 영업 마케팅그룹 부사장		Mr. Matthias Reiff 마티아스 라이프 다임러 범용화면 자체 & 외장 구매 공급 및 원자회 담당 디렉터		Dr. Doo-Soo Kim 김두수 인텔코리아 기술지원 총괄, 전무, PhD
--	---	--	---	---	---	---	--

SEDEX Participating Companies

2017 SEDEX Participating Companies



www.sedex.org

SEDEX 2018

20th Anniversary Semiconductor Exhibition

제20회 반도체대전

2018.10.17(WED)~10.19(FRI)
coex Hall C(3F), SEOUL

Sponsors 산업통상자원부 SAMSUNG 삼성전자 SK 이머니스 ST ilse.owned
Organizer KSIA 한국반도체산업협회

SEDEX Program I

프로그램 총괄안내

10월 17일(화)	시간	프로그램	주최
Hall E	10:00~12:00	반도체대전 오프닝 키노트	한국반도체산업협회
318호	13:00~17:00	IP-SoC Design Conference 2017	한국반도체산업협회
317호	09:30~17:00	스마트팩토리의 구현기업을 위한 모션솔루션 응용기술 세미나	성온미디어
327호	13:00~18:00	반도체시장 전망 및 산업 동향	한국반도체산업협회
반도체 기업 채용관	10:00~17:00	2017 반도체 디스플레이 Power Company Job Fair	한국반도체산업협회
전시장 C	13:00~17:00	국내소기업 구매상담회	한국반도체산업협회
314, 315호	10:00~17:00	해외바이어 초청 무역상담회	한국반도체산업협회

10월 18일(수)	시간	프로그램	주최
Hall E	10:00~15:00	반도체시장 전망 세미나	한국반도체산업협회
318호	10:00~16:00	IP-SoC Design Conference 2017	한국반도체산업협회
327호	10:00~16:00	반도체 IR Conference	한국반도체산업협회
Hall E(1~4)호	09:30~18:00	ISMP 2017(International Symposium on Microelectronics and Packaging)	한국마이크로전자 및 패키징학회
Hall E5호	09:30~18:00	2017 반도체 디스플레이 심포지엄	한국반도체디스플레이기술학회
반도체 기업 채용관	10:00~17:00	2017 반도체 디스플레이 Power Company Job Fair	한국반도체산업협회
전시장 C	13:00~17:00	국내소기업 구매상담회	한국반도체산업협회
314, 315호	10:00~16:00	해외바이어 초청 무역상담회	한국반도체산업협회

10월 19일(목)	시간	프로그램	주최
Hall E(1~4)호	09:30~18:00	ISMP 2017(International Symposium on Microelectronics and Packaging)	한국마이크로전자 및 패키징학회
Hall E5호	09:30~18:00	2017 반도체 디스플레이 심포지엄	한국반도체디스플레이기술학회

반도체시장 전망 세미나

- 일시 : 2017년 10월 18일(수) 10:00~15:50 • 장소 : COEX 컨퍼런스룸(남) 402호 • 주최 : 한국반도체산업협회
- 문의 : 한국반도체산업협회/조사홍보팀/송윤경 선임(Tel : 02-570-5223/e-mail : ksong@ksia.or.kr)

시간	내 용	주 최
10:00~10:40	4차 산업혁명과 반도체산업	한국반도체산업협회(안기현 상무)
10:40~11:20	반도체시장 성장에 따른 이슈 및 대응방안	미래에셋대우(도현우 연구원)
11:20~12:00	DRAM 반도체의 현주소와 향후 전망	SK하이닉스(박진송 수석)
12:00~13:30	중세 및 산업계 대응 방안	
13:30~14:10	다임러 동향 및 산업계 대응 방안	삼성전자(김일선 수석)
14:10~14:50	최신 패키징 기술 및 산업 동향	엘코테크놀로지(박성준 수석)
14:50~15:10	Coffee Break	
15:10~15:50	2018년 반도체산업 전망	이세철 연구원

IP-SoC Design Conference 2017 세부일정

- 일시 : 2017년 10월 17일(화)~18일(수) • 장소 : COEX 컨퍼런스룸(남) 318(B,C)호 • 주최 : 한국반도체산업협회
- 문의 : 한국반도체산업협회/산업지원팀/최수연 주임(Tel : 02-570-5273/e-mail : sychoi@ksia.or.kr)

날 짜	시간	내 용	연 사
Day 1 10/17 (화)	13:00~13:30	Registration	
	13:30~14:50	[Foundry Session] Vibrant City of Innovative Industries and Pioneering Citizens-22Fdx Value added platform for Analog-Power applications-BCD/BCDlite	GLOBALFOUNDRIES
	14:50~15:10	Break	
	15:10~15:40	[Invited Talk] Autonomous Driving & Sensors	한일테크노 하진수 교수
	15:40~16:10	[IP Session] Power Management for IoT SoC Design	Avant Technology
	16:10~16:40	[IP Session] ROIC'S AFE IP for Complex Environment	LeoLSI
	16:40~17:10	[IP Session] Analog IPs for ROIC Sensors	Cesign
	09:30~10:00	Registration	
	10:00~10:30	[Invited Talk] Automotive Solutions for meeting ISO26262 requirements	Synopsys
	10:30~11:00	[IP Session] Idea to Silicon	Cortus
Day 2 10/18 (수)	11:00~11:30	[IP Session] Cost-Effective Memory Testing Solutions for AI and Automotive Application	Hoy Technology
	11:30~12:00	[IP Session] Smarten up Your Chips with Andes Embedded	Andes Technology
	12:00~13:00	Break	
	13:00~15:00	[Foundry Session] Mie Fujitsu Semiconductor Automotive IC Manufacturing and Quality Management Fujitsu FRAM opens up automotive market	Fujitsu Electronics
	15:00~15:20	Break	
	15:20~15:50	[Invited Talk] Accelerator-Centric System for Scalable and Energy-Efficient Deep Learning	POSTECH 윤민수 교수
	15:50~16:20	[IP Session] Faraday ASIC Platform Solution for IoT, Automotive and Cloud	Semiconductor(Faraday)
	16:20~16:50	[IP Session] Camera image processing for VR/MR/AR	MnH

SEDEX Program II

반도체 IR Conference

- 일시 : 2017년 10월 18일(수) 10:30~16:00 • 장소 : COEX 컨퍼런스룸(남) 327호 • 주최 : 한국반도체산업협회
- 프로그램 : 반도체기업 공개 기업설명회, 반도체기업-투자자 간 개별 투자미팅
- 문의 : 한국반도체산업협회/전략기획팀/이지연 선임(Tel : 02-570-5295/e-mail : jlyee@ksia.or.kr)

스마트팩토리의 구현기업을 위한 모션솔루션 응용기술 세미나

- 일시 : 2017년 10월 17일(화) 09:30~17:00 • 장소 : COEX 컨퍼런스룸(남) 317(B,C)호 • 주최 : 상온미디어
- 문의 : 상온미디어/전시컨벤션사업부/김근민 대리(Tel : 02-824-7282/e-mail : visionsys@visionsystem.kr)

시간	내 용		연 사
09:30~11:00	Industry 4.0 시대로의 초대		발루프 코리아(유)/서경민 차장
11:00~12:30	대면적 고속 레이저 가공을 위한 모션 제어		프래스트 솔루션(주)/김욱 차장
12:30~14:00	Lunch		
14:00~15:30	Handling system guide and Electric Drives New Innovative Motion Terminal		한국핵스트(주)/이동진 차장 한국핵스트(주)/윤종태 차장
15:30~15:40	Coffee Break		
15:40~17:00	EtherCAT과 Soft Motion: Smart Factory에 최적인 차세대 모션 제어 기술 소개		소프트모션엔로보틱스(주)/임부호 대표

ISMP 2017

- 일시 : 2017년 10월 18일(수)~19일(목) • 장소 : COEX 컨퍼런스룸(남) Hall E(1~4)호
- 주최 : (사)한국마이크로전자및패키징학회
- 문의 : (사)한국마이크로전자및패키징학회/박소윤 간사(Tel : 02-538-0962/e-mail : kmeps@kmeps.or.kr)

1st day : October 18th(Wed)

Time	Rm E1	Rm E3	Rm E4
09:30~11:00	Session 1 3D Printing and Novel Process for Electronics	Session 2 Automotive Electronics	Session 3 Wearable and Stretchable Electronics
11:00~11:20	Coffee break		
11:20~11:30	Opening Ceremony		
11:30~12:20	Plenary Talk 1 : Packaging Technology Trends Usher in a New Era for Integration / Byung Joon Han (Stats ChipPAC/Singapore)		
12:20~13:30	Lunch		
13:30~14:10	Keynote Talk 1 : Hurdles and Opportunities for Next Generation Packaging in Mobile & Wearable Systems / Michael Pena (Amkor Technology Korea/Korea)		
14:10~14:50	Keynote Talk 2 : Bonding Cu Pillars by Using the Microfluidic Electroless Interconnection (MELI) Process / C. R. Kao (National Taiwan University/Taiwan)		
14:50~15:10	Coffee break		
15:10~16:20	Session 4 Emerging Electronic Package	Session 5 Quality, Modeling, Simulation	Session 6 Electronic Nanomaterials and Nanoprinting
16:20~18:00	Poster Presentation Session 1		

2nd day : October 19th(Thu)

Time	Rm E1	Rm E3	Rm E4
09:20~10:45	Session 7 Emerging Interconnect Technology	Session 8 Reliability for Electronic Components	Session 9 Electronic Materials and Processing I
10:45~11:00	Coffee break		
11:00~11:50	Plenary Talk 2 : Hybrid Film and Process Innovations for Emerging Device Technologies: Understanding Relationships between Structure, Processing and Function / Reinhold H. Dauskardt		
11:50~12:20	General Meeting		
12:20~13:30	Lunch		
13:30~14:10	Keynote Talk 3 : Scaling Effects on Reliability of Through-Silicon Vias in Microelectronic Packaging / Jang-hi Im (The University of Texas, Austin/USA)		
14:10~14:50	Keynote Talk 4 : In-situ Microscopy Studies on Microelectronic Materials and Devices / Aman Haque (Penn State University/USA)		
14:50~15:10	Coffee break		
15:10~16:40	Session 10 Sensors	Session 11 Soldering and Surface Mount Technology	Session 12 Electronic Materials and Processing II
16:40~17:30	Poster Presentation Session 2		
17:30~18:00	Award Ceremony and Closing Remark		

SEDEX Program III

반도체디스플레이 심포지엄(SSD 2017)

- 일시 : 2017년 10월 18일(수)~19일(목) 09:00~17:50 • 장소 : COEX Hall E5호(3층)
- 주최 : 한국반도체디스플레이기술학회
- 문의 : 한국반도체디스플레이기술학회/사무국(Tel: 041-555-5744/ e-mail : ksdtd@ksdtd.kr)

날 짜	시간	내 용	연 사
1일차 시회 : 최자성 교수	09:00~09:50	등록 및 네트워킹	
	09:50~09:55	개회식	원영훈 교수(조직위원장, 성공관대)
	09:55~10:00	인사말	신승민 교수(학회장, 경기대)
	10:00~10:40	세션 (I : 차세대반도체소자) 최장: 권기원 교수(성균관대)	송광준 PDK(KEIT)
	10:40~11:20	산업부 반도체 공정/장비 R&D 전략	전종신 연구원(SK하이닉스)
	11:20~12:00	HBM DRAM Technology and Architecture	배종일 수석(삼성전자)
	12:00~12:30	차세대반도체 소자기술(토론)	
	12:30~13:00	점심 식사 (80분)	
	13:00~13:30	세션 (II : 미래반도체소자) 최장: 이기원 교수(충남대)	
	13:30~14:00	MT) beyond memory element - to find applications for computation, logic to neuromorphic computing	박원준 교수(한양대)
2일차 시회 : 최자성 교수	14:00~14:40	채구성을 통한 기계학습소자 기술	권기원 교수(성균관대)
	14:40~15:20	2D 반도체소자기술	이성주 교수(성균관대)
	15:20~15:40	Coffee Break (20분)	
	15:40~16:20	세션 (III : EUV 기술) 최장: 안진호 교수(한양대)	
	16:20~17:00	Status of EUV Lithography Tool Development	이성우 이사(ASML)
	17:00~17:40	EUV Mask Readiness for HVM	정창원 수석(삼성전자)
	17:40~17:50	Status of EUV pellicle development	안진호 교수(한양대)
	17:50~18:00	1일차 정리 (조직위원장)	
	09:00~09:50	등록 및 네트워킹	
	09:50~10:00	인사말	원영훈 교수(조직위원장, 성공관대)
3일차 시회 : 최자성 교수	10:00~10:30	세션 (IV : 공정전단 기술) 최장: 김근호 교수(서울대)	
	10:30~11:00	플라즈마 데이터 기반의 공정 해석 및 제어연구	윤창식 부센터장(NERI)
	11:00~11:30	OES 기술의 반도체/디스플레이 적용	허 민 책임(KIMM)
	11:30~12:00	플라즈마 공정전단기술	정찬호 교수(한양대)
	12:00~12:30	플라즈마 장비부품 운영 평가 연구	송재범 연구원(KRISIS)
	12:30~13:00	점심 식사 (80분)	
	13:00~13:30	차세대 ALD 장비 기술	성대근 박사(ASM)
	13:30~14:00	Next Generation Thin Film Technology	이선길 박사(ATEL)
	14:00~15:20	차세대 PVD 장비 기술	최승호 상무(LUVAC)
	15:20~15:40	Coffee Break (20분)	
4일차 시회 : 최자성 교수	15:40~16:20	차세대 식각 장비 기술	김유진 박사(Lam Research)
	16:20~17:00	최신 패시징 장비 기술동향	김구철 교수(강원대)
	17:00~17:40	반도체장비 개발 및 개선 전략적 문제해결방법(TRIZ)	김호중 대표(필라스트리크)
	17:40~17:50	2일차 정리 및 폐회 (조직위원장)	

반도체 산업 직무 특강 및 컨설팅

- 일시 : 2017년 10월 17일(화) 13:00~18:00 • 장소 : COEX 컨퍼런스룸(남) 327호 • 주최 : 한국반도체산업협회
- 문의 : 한국반도체산업협회/인력지원개발팀 한정민 주임(Tel : 02-570-5217/e-mail : jkong@ksia.or.kr)

시간	내 용	연 사
13:00~14:00	반도체 산업 현황 및 전망	이창훈(반도체 직무기술 전문강사)
14:00~15:00	반도체 소자기술 직무 및 취업 역량	이창훈(반도체 직무기술 전문강사)
15:00~16:00	반도체 설계기술 직무 및 취업 역량	송병배(스마트비 기술총괄이사)
16:00~17:00	반도체 장비기술 직무 및 취업 역량	전대식(영지대학교 산학협력교수)
17:00~18:00	첨여 강사들의 질의응답	ALL

Hall C

SEDEX 2017

[illegible]

업체명	부스번호	업체명	부스번호	업체명	부스번호
건흥건설	G040	시모텍 주식회사	B080	(주)한국테크노파크 스마트시스템센터	C064
국가핵융합연구소	G080	시자인	B080	커비엔	A062
(주)제산시스템	H060	셀퓨스 주식회사	G063	(주)케이에스엠	D009
(주)굿모닝제육기	E082	이코브	G063	케이엔아이	M001
글로벌바이오리츠	G060	이브테크놀로지	B080	(주)케이엘티	G065
나노 융합 기술원	G080	(주)이시물류	E024	코리아스마트빌드프록트(주)	C064
나노-텔코리아	D044	(주)이시엔지니어	B021	고미	H102
넬슨코리아(주)	G026	이시엔 파빌리온	B021	고무쓰 코야마	A081
(주)네스틴	C022	(주)이스트리크스 코리아	K060	(주)구오민	B022
누리콤	K040	인덕스테크놀로지	K060	글렉	C022
(주)누리콤	C046	일렉트릭	G065	(주)글라티트	G062
(주)뉴캐임프라이즈	G080	일렉트로랩	A040	큐비케이저시스템	E022
다스코리아(주)	E020	(주)일렉트론플러스	G066	큐필드 주식회사	G100
다인큐브	K080	(주)에코리	D046	카엔스코리아(주)	E002
(주)다트비전	M013	에스디에이비즈니스	K045	(주)레강시스템	M020
대에이(엘지화학산업전력)	E003	에스디에이비테크	K041	테크노-엘스 코리아 주식회사	K016
대에이(문앤컴)	H062	(주)에이시이코리아	E043	테크노엔 주주회사	B020
동양정밀공업	G088	(주)에스엔텍	D040	테오안스코리아 주식회사	E060
(주)동원인식	D063	에스디에이비인스	G120	투시스코리아	H103
주식회사 동진베미랩	E120	에스디에이비테크 일렉트로닉스	D100	(주)트윈터	H070
(주)동화자동차	K101	(주)에스티아이	G101	더엔젤스엔터프라이즈	E008
두루큐브	K100	(주)에스티아이	K081	주식회사 탑즈	B080
(주)에스티에스넷	K120	(주)에스피지	H104	주식회사 태두	B080
(주)에스티테크놀로지	G067	에이디텍놀로지	H041	(주)스노텍	B080
다케이(주) 주식회사	H083	(주)에이디텍스	D102	(주)스노텍	H148
(주)다카미	D083	(주)에스비온	G103	파리슨	H148
다원테크	C040	엘렉 주식회사	B080	주식회사 퍼먼디(퍼먼인웍스)	E001
(주)러온파울	A040	에이비아이	E066	주식회사 퍼픽솔루션	B080
레온테크(주)아이	D080	엘렉스텍	B021	(주)파리슨(주)세파울	C100
레이저시스템코리아	D060	주식회사 엘로비에스	M004	테라이온	C024
로움 주식회사	C062	엘비텍	K061	포항공과대학교 나노융합기술원	C024
(주)로비	E100	(주)엘노텍	E085	(주)프리드솔루션	G062
마하디시스템즈	E040	영안테크(이치넷)	B080	(주)프리드솔루션	H062
마하디시스템즈	B025	오르비엔지니어링	B080	블루스시스템즈	E047
망지테크	G080	올림피아스 주식회사	C020	(주)블루스텍	M015
반도계 - 디스플레이 공정/전력/전자재료 홍보관	G080	주식회사 오원테크코리아	B080	(주)피디비	E086
반도계 Power Company Job Fair	A001	(주)오원테크(이치넷)	G102	파워이코리아	B080
(주)반도계 워크숍	B068	주식회사 우일솔루션	E007	파워게이	C022
(주)비솔로	H048	원픽IPS	C121	(주)피픽	D163
신산전기(주)코리아	H103	원픽시스템즈	C121	하이엔지니어 코리아 주식회사	M020
삼성전자(주)	A020	(주)원큐	B080	하이원큐퍼레이션(주)	G066
삼미엔지니어	G102	유니테크	D086	한국구보대정공회	K002
사물극조글로벌	B020	유니테크	D061	한국구보대정공회	K002
(주)산경시스템	E005	(주)유니테크(주)비엔	B080	(주)한국 마루이	E021
신재하이테크	C060	(주)이클라우드	H089	한국센서시스템	B080
성원테크(주)주식회사	M003	이클라우드	H101	한국소켓텍	D065
(주)성일기공	H120	(주)이비지테크코스	K124	한국솔라텍	C020
세메스(주)	B001	(주)이엔지테크(주)엔원	B080	한국솔라텍엔지니어링(주)	A100
(주)세미솔루션	C042	(주)이엔지테크놀로지	M017	한국전자통신연구원	E064
세우산전자	K001	이온시스템	D120	한국전지(주)솔루션주조합	H022
세비스(주)	B080	(주)이비지테크코스	D140	(주)한국세진인도	D028
소프트로엔지니어링	B080	인포테크(주)	D063	한국표준과학연구원	B023
스마트컴퓨터시스템	H020	지스이 코리아	C027	한국표준과학연구원	B023
(주)신성아이엔지	G001	전방테크(주)원	E044	(주)한신세진	H118
(주)신코	B043	전지자회사	D008	셀코 솔라리드 시스템즈 리미티드	M024
(주)실리코퍼미티비	C120	(주)세프가인코	D063	(주)한솔엔지니어링	H001
(주)실리코퍼텍스	C001	(주)세종기공	B065	홍이테크놀로지	C001
판이(이)정 주식회사	D084	지엔비	M004	주식회사 호인텍	H108
(주)박재하이테크노	E006	(주)지스일렉트론	G080	후지쓰(인텔)테크노코리아(주)	C101
페이온	E004	주식회사 지지점	H040	후지쯔	G048
(주)페리온(주)비	D064	충진	B107	(주)히닉스컴퍼니	C024

※ 반도체대전 참가사의 제품품목, 회사소개 등 기타 자세한 사항은 <온라인 디렉토리>에서 확인 가능합니다. www.SEDEX.org ▶ 전시회 정보 ▶ 참가사 디렉토리

Exhibitor	Booth No.	Exhibitor	Booth No.	Exhibitor	Booth No.
3AC Co., Ltd.	E004	Hyunjin FA	G001	PLUSTEK Co., Ltd.	M019
ADTechnology Co., Ltd.	B100	IAN Engineering Co., Ltd.	H080	POSTECH NINT	O024
Akris Co Korea, Ltd.	K060	II-VI Korea	B121	PRESTOSOLUTION Ltd.	H062
ALLRING TECH KOREA Co., Ltd.	K080	IMA Co., Ltd.	B103	Prime Solution Co. Ltd.	H063
Alpha Global	A045	ImageFocus Co., Ltd.	H104	PSK	B163
ALPHAPIUS Co., Ltd.	A046	INFOVIEW INC.	D123	Qbic Laser System INC.	F102
Andes Technology	C080	IOVIS Co., Ltd.	C040	Qlight Co., Ltd.	G122
Aref Co., Ltd.	D066	IP Pavilion	C080	QRT INC.	G100
ARGO Co., Ltd.	B060	IRSEA SYSTEM	H085	Quopin	B022
ASFLOW Co., Ltd.	E024	Jesagi Hankook Ltd.	D005	QUACITECH INC.	B021
ATIS Co., Ltd.	D083	JOB AIR	A001	RPTT Co., Ltd.	B021
Avant Technology INC.	C080	JOEUN TECHNOLOGY Co., Ltd.	B063	Rittal Co., Ltd.	C160
Cision INC.	C080	K&I	M009	ROHM Co., Ltd.	E102
CHOMDAN	B047	KEYENCE Korea Co., Ltd.	E002	SAMSUNG ELECTRONICS Co., Ltd.	A120
CHUNGBUK TECHNOPARK Smart System Center	C064	KL T Co., Ltd.	E035	SANYODENKI KOREA Co., Ltd.	B103
Cmosetec Corporation	B080	KOMI	H102	SB8 TECH	K041
COFFEE LOUNGE	A062	KOREA ILLITES OF KOREA Co., Ltd.	E064	Scinco Co., Ltd.	B043
COOLTEC	G043	Korea Institute of Machinery and Materials	G080	Sealink Corp.	G162
Cortus Korea	A083	Korea Research Institute of Standards and Science(KRISs)	B023	SEMCS	B006
DaeDUGEMHOREsban Corporation	E001	Korea Research Institute of Standards and Science(KRISs)	B023	SEMES Co., Ltd.	B001
DAINCUBE	K080	Korea Sensor Lab	B068	Semiconductor Network SEMON	C064
DAS Korea Co., Ltd.	E020	KOREA SPECTRAL CENTER	D065	Semisation INC.	O042
DATVISION Co., Ltd.	C083	KOREA SPECTRAL PRODUCTS INC.	B068	SenVivs Co., Ltd.	B080
DI-K-Lock Corporation	H102	Korea Strategic Trade Institute	D048	SEWOO INDUSTRIAL SYSTEMS Co., Ltd.	K081
DKM Motor Co., Ltd.	K080	Korea Vacuum-technology Research Association	O048	SH KOREA	G043
DONG WHA AUTOMATION Co., Ltd.	E163	Korean Society of Semiconductor & Display Technology	G080	Shinsung ENG Co., Ltd.	E001
DONGIL ENT Co., Ltd.	D120	KSM Co., Ltd.	D001	Silicon Mitus Inc.	C120
Dongjin Semichem Co., Ltd.	E106	Kukje Industrial Machinery Corporation	H060	Silicon Works Co., Ltd.	C101
DONGYANG PRECISION ENGINEERING Co., Ltd.	H088	KURODA PRECISION INDUSTRIES KOREA LTD.	K002	SK hyinx	G120
DST Robot	K162	LAONPEOPLE	C040	SNTK	G100
Dynamic Motion Technology Co., Ltd.	G067	Lead Spectorix	C060	Soft Motions & Robotics	H023
Electronic Resources	D088	LeiSci	D080	SONG WUN TRADING Co., Ltd.	O009
Electronics and Telecommunications Research Institute(ETRI)	A100	LSI Co., Ltd.	M001	SPG Co., Ltd.	H041
ELPATC	K061	MIDAS KOREA INC.	B121	SPO INC.	K081
ELVESSE Corporation	D180	MIDAS IT	E025	Start-up Showcase	B080
EO TECHNICS Co., Ltd.	D120	MIDAS SYSTEM Co., Ltd.	E040	STI Co., Ltd.	D180
Eraesent	E021	mm-nh	C102	STMicroelectronics	H100
ES-Technology	M017	MSOTEC INC.	E185	Surg-II Machinery Co., Ltd.	D120
eWEM	G102	NANOTEM Korea, Ltd.	D024	SUNG H-W TECH.	O060
EXKON Co., Ltd.	C102	National Fusion Research Institute	G080	SUNPOYONG S.T Co., Ltd.	E005
FACO International Co., Ltd.	G100	National Nano FAB Center	G080	SUNPOTTECH CO., Ltd.	E006
FADU, INC.	B080	New Power Plasma Co., Ltd.	G080	SurfSmiling Co., Ltd.	A080
FAINSTECH Co., Ltd.	H108	Nexfin INC.	C022	SurplusGLOBAL	A080
Faraday Technology Corporation	C042	N-FLEX	B066	SVCS	K045
FASTECH Co., Ltd.	H080	NITECH Co., Ltd.	E024	TAC GUN SYSTEM	B020
FASTECH Co., Ltd.	H148	NUBKON, INC.	C046	TEAMS Corporation	O020
fineDNC Co., Ltd. (FineChms)	E012	NURI ROBOT	O040	Technohandskoma Co., Ltd.	B016
Fujitsu Electronics Korea Ltd.	C101	OLYMPUS KOREA CO., Ltd.	C020	TechniWid Co., Ltd.	O100
GGM	H100	Orel Semiconductor INC.	B080	The SEMICON magazine	G062
GLOBALFOUNDRIES	B060	PAIX	E086	TMSRF	E068
GMI Co., Ltd.	E082	PDT Co., Ltd.	E086	TOYOTANSO KOREA Co., Ltd.	E100
GNB	M004	Physik Instrumente Korea	H040	Tri-n	K101
GO Element	G080	Pinuslink	H040	TRUE TRADING Co., Ltd.	H070
HANKOOK CHAIN MOTOR Co., Ltd.	H072	PLT Co., Ltd.	O067	ULVAKOREA, Ltd.	D020
Hanshin Chain Co., Ltd.	M022	PLUS TECH, Ltd.	D062	UNILAM	O080
HEIDENHAIN Korea Ltd.	H006			Vissio INC.	H068
Hepco Slide Systems Limited	H124			Wingcore Technology INC.	O080
HICS COMPANY	G020			WONIK HOLDINGS	C121
HIWIN Corporation	B080			WONIKIPS Co., Ltd.	C121
HY Technologies	C080			Wooli Flucon Co., Ltd	E007
Humen	G048			YIK Corporation	G102
				YUMINIST	D061
				ZEISS Korea	D061

Hall D

2017

입출구

입출구

Booths and Exhibitors:

- A01** 케이맥
- A02** 엘엠에스
- A03** 영신 일렉트릭
- A04** 피에스텍
- A05** 이즈소프트
- A06** 티엘씨 테크 파스트
- A07** 엘엠티
- A08** 세우인 코퍼레이션
- A09** 노바센트릭스
- A10** 아이백 코리아
- A11** 신한 과학
- A12** HB 테크놀로지
- A13** 중원 동상
- A14** ELDIM S.A.
- A15** 태훈 CST
- A16** 액사이언스
- A17** 브라쉬뱅크
- B01** LG디스플레이
- B02** 마크마포먼스머티리얼즈
- B03** 삼성디스플레이
- B04** 필옵틱스
- B05** AP시스템
- B06** 에스피텍
- B07** RMS 테크놀로지
- B08** 나노텍
- B09** 오디에이 테크놀로지
- B10** 두리마이 크루
- B11** 한맥 전자
- B12** 유비테크
- B13** 핑토 테크놀로지
- B14** 좋은 세상
- B15** 케이시엠시
- C01** 금성에이시스템
- C02** 인베니아
- C03** 플랜트하스 전자재료코리아
- C04** 케이씨텍
- C05** SFA
- C06** 인터랙스텍 노로지
- C07** 에이맨
- C08** 스페이스 솔루션
- C09** 주원
- C10** 중국기업관
- C11** 우수제품 전시관
- C12** 유한킴벌리
- C13** 유한킴벌리
- C14** 유한킴벌리
- C15** 유한킴벌리
- C16** 유한킴벌리
- C17** 유한킴벌리
- C18** 유한킴벌리
- C19** 유한킴벌리
- C20** 유한킴벌리
- C21** 유한킴벌리
- C22** 유한킴벌리
- C23** 유한킴벌리
- C24** 유한킴벌리
- C25** 유한킴벌리
- C26** 유한킴벌리
- C27** 유한킴벌리
- C28** 유한킴벌리
- C29** 유한킴벌리
- C30** 유한킴벌리
- C31** 유한킴벌리
- C32** 유한킴벌리
- C33** 유한킴벌리
- C34** 유한킴벌리
- C35** 유한킴벌리
- C36** 유한킴벌리
- C37** 유한킴벌리
- C38** 유한킴벌리
- C39** 유한킴벌리
- C40** 유한킴벌리
- C41** 유한킴벌리
- C42** 유한킴벌리
- C43** 유한킴벌리
- C44** 유한킴벌리
- C45** 유한킴벌리
- C46** 유한킴벌리
- C47** 유한킴벌리
- C48** 유한킴벌리
- C49** 유한킴벌리
- C50** 유한킴벌리
- C51** 유한킴벌리
- C52** 유한킴벌리
- C53** 유한킴벌리
- C54** 유한킴벌리
- C55** 유한킴벌리
- C56** 유한킴벌리
- C57** 유한킴벌리
- C58** 유한킴벌리
- C59** 유한킴벌리
- C60** 유한킴벌리
- C61** 유한킴벌리
- C62** 유한킴벌리
- C63** 유한킴벌리
- C64** 유한킴벌리
- C65** 유한킴벌리
- C66** 유한킴벌리
- C67** 유한킴벌리
- C68** 유한킴벌리
- C69** 유한킴벌리
- C70** 유한킴벌리
- C71** 유한킴벌리
- C72** 유한킴벌리
- C73** 유한킴벌리
- C74** 유한킴벌리
- C75** 유한킴벌리
- C76** 유한킴벌리
- C77** 유한킴벌리
- C78** 유한킴벌리
- C79** 유한킴벌리
- C80** 유한킴벌리
- C81** 유한킴벌리
- C82** 유한킴벌리
- C83** 유한킴벌리
- C84** 유한킴벌리
- C85** 유한킴벌리
- C86** 유한킴벌리
- C87** 유한킴벌리
- C88** 유한킴벌리
- C89** 유한킴벌리
- C90** 유한킴벌리
- C91** 유한킴벌리
- C92** 유한킴벌리
- C93** 유한킴벌리
- C94** 유한킴벌리
- C95** 유한킴벌리
- C96** 유한킴벌리
- C97** 유한킴벌리
- C98** 유한킴벌리
- C99** 유한킴벌리
- C100** 유한킴벌리
- D01** 한국 신소재 실라본
- D02** 신코퍼레이션
- D03** 선익 시스템
- D04** 지더블 유캐드 코리아
- D05** 탑엔지니어링
- D06** 씨이케이
- D07** 청도이앤지
- D08** 인피텍
- D09** 아이산
- D10** 중국기업관
- D11** 우수제품 전시관
- D12** 유한킴벌리
- D13** 유한킴벌리
- D14** 유한킴벌리
- D15** 유한킴벌리
- D16** 유한킴벌리
- D17** 유한킴벌리
- D18** 유한킴벌리
- D19** 유한킴벌리
- D20** 유한킴벌리
- D21** 유한킴벌리
- D22** 유한킴벌리
- D23** 유한킴벌리
- D24** 유한킴벌리
- D25** 유한킴벌리
- D26** 유한킴벌리
- D27** 유한킴벌리
- D28** 유한킴벌리
- D29** 유한킴벌리
- D30** 유한킴벌리
- D31** 유한킴벌리
- D32** 유한킴벌리
- D33** 유한킴벌리
- D34** 유한킴벌리
- D35** 유한킴벌리
- D36** 유한킴벌리
- D37** 유한킴벌리
- D38** 유한킴벌리
- D39** 유한킴벌리
- D40** 유한킴벌리
- D41** 유한킴벌리
- D42** 유한킴벌리
- D43** 유한킴벌리
- D44** 유한킴벌리
- D45** 유한킴벌리
- D46** 유한킴벌리
- D47** 유한킴벌리
- D48** 유한킴벌리
- D49** 유한킴벌리
- D50** 유한킴벌리
- D51** 유한킴벌리
- D52** 유한킴벌리
- D53** 유한킴벌리
- D54** 유한킴벌리
- D55** 유한킴벌리
- D56** 유한킴벌리
- D57** 유한킴벌리
- D58** 유한킴벌리
- D59** 유한킴벌리
- D60** 유한킴벌리
- D61** 유한킴벌리
- D62** 유한킴벌리
- D63** 유한킴벌리
- D64** 유한킴벌리
- D65** 유한킴벌리
- D66** 유한킴벌리
- D67** 유한킴벌리
- D68** 유한킴벌리
- D69** 유한킴벌리
- D70** 유한킴벌리
- D71** 유한킴벌리
- D72** 유한킴벌리
- D73** 유한킴벌리
- D74** 유한킴벌리
- D75** 유한킴벌리
- D76** 유한킴벌리
- D77** 유한킴벌리
- D78</**